

2024年10月4日

タツモ株式会社

## 日台半導体コラボレーションに関する覚書の締結に関するお知らせ

当社は本日、TAIFLEX Scientific Co.,Ltd,(台湾)と「日台半導体コラボレーションの覚書」を締結いたしました。

TAIFLEX 社は、フレキシブルプリント基板材料分野においてトップシェアを占めております。近年では最先端の半導体パッケージング材料の研究開発に取り組み、その関連製品は既に半導体パッケージング分野のサプライチェーンに導入されております。

当社と TAIFLEX 社は、互いの技術と顧客サービス能力が補完的であることを認識し、顧客により良いサービスを提供するための協力関係を強化するため、日台半導体コラボレーションの覚書を締結いたしました。名称は、日本の装置メーカーと台湾の先端材料メーカーが互いのリソースを統合するという意欲を示すため、TAZMO と TAIFLEX の頭文字を冠した「T&T Alliance」と名付け、更なるサプライチェーンサービスの強化を目指してまいります。

T&T Allianceの対象顧客には、ファウンドリやパッケージングのテストなどの一流メーカーが含まれており、日本の装置メーカーの技術サポートと台湾でのリアルタイムサービス機能を通じて、更なる拡販を狙ってまいります。

また、大手半導体メーカーが日本に投資したことにより、T&T Alliance の設立は台湾と日本の半導体サプライチェーンの川上と川下の綿密な協力体制を深め、顧客が必要とする製品とサービスの提供を加速することを目指してまいります。

お互いの利点を補完することで両社は強力な競争優位性を実証し、国際半導体分野での主導的な地位を確保するよう取り組んでまいります。

以上